

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

CONSULTA PÚBLICA Nº 13, DE 28 DE MAIO DE 2013

A Secretária do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de alteração de Processo Produtivo Básico - PPB.

Manifestações podem ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, ao e-mail: [cgel.ppb@mdic.gov.br](mailto:cgel.ppb@mdic.gov.br).

HELOÍSA REGINA GUIMARÃES MENEZES

ANEXO

PROPOSTA Nº 068/11 - ALTERAÇÃO DE PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO ESTABELECIDO PELAS PORTARIAS INTERMINISTERIAIS Nº 201 E 202, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA OS PRODUTOS COMPONENTES SEMICONDUTORES, DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS, COMPONENTES A FILME ESPESSO OU A FILME FINO, CÉLULAS FOTOVOLTAICAS e MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL PADRONIZADOS:

OBS : A Proposta está em formato de minuta de Portaria (Versão Lei de Informática).

Art. 1º Os Processos Produtivos Básicos para os produtos COMPONENTES SEMICONDUTORES, DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS, COMPONENTES A FILME ESPESSO OU A FILME FINO, CÉLULAS FOTOVOLTAICAS e MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL PADRONIZADOS, estabelecidos pela Portaria Interministerial MCT/MICT nº 201, de 13 de novembro de 2007, passam a ser conforme os artigos seguintes.

Art. 2º COMPONENTES SEMICONDUTORES e DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS:

- I - corte da lâmina (wafer);
- II - montagem e fixação da pastilha não encapsulada (die);
- III - soldagem dos fios;
- IV - moldagem ou encapsulamento da pastilha montada;
- V - corte ou fixação de esferas para componentes com encapsulamento BGA (Ball Grid Array ) ou FBGA (Fine Ball Grid Array), quando aplicável;
- VI - estanhagem e dobra para componentes com encapsulamento TSOP (Thin Small-Outline Packages) ou similar, quando aplicável;
- VII - corte ou singularização, quando aplicável;
- VIII - teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e
- IX - marcação (identificação).

§ 1º Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrômetros (micra) e os diodos de potência deverão também realizar o processamento físico-químico da pastilha semicondutora no País.

§ 2º Os circuitos integrados projetados no País, nos termos da Portaria MCT no 950, de 12 de dezembro de 2006, ficam dispensados de realizar a etapa constante do inciso I do caput.

§ 3º As etapas descritas no caput aplicam-se aos dispositivos semicondutores das posições 85.41 e 85.42 da NCM, que utilizem a tecnologia de montagem mediante o processo chip on board diretamente sob placa de circuito impresso, com exceção das etapas IV, V e VI.

#### Art. 3º COMPONENTES A FILME ESPESSE OU A FILME FINO:

- I - processamento físico-químico sobre o substrato;
- II - montagem dos componentes sobre o substrato, quando aplicável;
- III - teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e
- IV - marcação (identificação).

Parágrafo único. Para a produção de circuitos integrados híbridos, ficam dispensados de atender ao disposto no caput do art. 2º desta Portaria os componentes semicondutores utilizados como insumos na produção dos mesmos.

#### Art. 4º CÉLULAS FOTOVOLTAICAS:

- I - processamento físico-químico referente às etapas de difusão, texturização e metalização;
- II - corte da lâmina; e
- III - teste (ensaio).

#### Art. 5º MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS:

- I - corte da lâmina (wafer);
- II - montagem e fixação da pastilha não encapsulada (die);
- III - soldagem dos fios;
- IV - moldagem ou encapsulamento da pastilha montada;
- V - corte ou fixação de esferas para componentes com encapsulamento BGA (Ball Grid Array) ou FBGA (Fine Ball Grid Array), quando aplicável;
- VI - estanhagem e dobra para componentes com encapsulamento TSOP (Thin Small-Outline Packages) ou similar, quando aplicável;
- VII - corte ou singularização, quando aplicável;
- VIII - teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico;
- IX - marcação (identificação);
- X - montagem e soldagem dos componentes na placa de circuito impresso;
- XI - gravação da memória do tipo Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - EEPROM ou do circuito integrado controlador; e

XII - testes elétricos, funcionais e etiquetagem para identificação dos módulos, quando aplicável.

§ 1º As etapas constantes dos incisos de I a X deste artigo poderão ser dispensadas em, até, 2% (dois por cento) do total de MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS produzidos, no ano-calendário.

§ 2º Poderão ser utilizados circuitos integrados monolíticos do tipo memória de acesso aleatório (Random Access Memory - RAM) importados num percentual máximo de, até, 20% (vinte por cento) na montagem local dos MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADOS produzidos, no ano-calendário.

§ 3º Adicionalmente ao § 2º, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos circuitos integrados do tipo memória importados utilizados na montagem dos MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADO deverão ser marcados e testados no Brasil.

§ 4º A obrigatoriedade estabelecida no § 3º poderá ser dispensada caso a empresa fabricante opte por utilizar circuitos impressos produzidos conforme seu respectivo Processo Produtivo Básico num percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de todas as placas de circuitos impressos utilizadas na produção de MÓDULOS DE MEMÓRIA VOLÁTIL, PADRONIZADO, no ano-calendário.

Art. 6º As atividades ou operações inerentes às etapas de produção para cada produto referido no caput do art. 1º desta Portaria poderão ser realizadas por terceiros, desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, exceto uma, que não poderá ser objeto de terceirização.

Art. 7º Anualmente, as empresas fabricantes deverão encaminhar às Secretarias de Política de Informática - SEPIN, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Secretaria do Desenvolvimento da Produção - SDP, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, até 31 de março do ano posterior, relatório contendo informações referentes à utilização dos percentuais de circuitos integrados do tipo memória e de módulos de memória montados, importados, previstos nestes artigos desta Portaria.

Parágrafo único. O não envio das informações acima citadas por parte da empresa, bem como o não cumprimento dos percentuais estabelecidos nesta Portaria caracterizará o não cumprimento do Processo Produtivo Básico, ficando a empresa sujeita às penalidades previstas no art. 9º da Lei no 8.248, de 1991, e no art. 36 do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006.

Art. 8º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa dos Processos Produtivos Básicos poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 9º Fica revogada a Portaria Interministerial MCT/MICT N° 201, de 13 de novembro de 2007.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.